

放熱基板技術ラインナップ

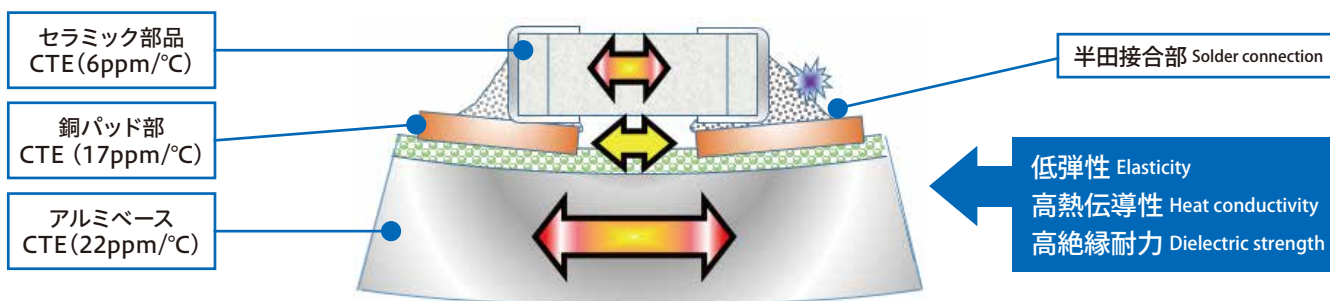
Heat dissipation PWB technologies

特長 Features

- ✓ 最適な材料と構造を組み合わせたメイコー独自のメタルベース基板をご提供致します。
Meiko will meet various SMT requirements with various structure proposals.

耐半田クラック高信頼性技術 Anti solder crack high reliability technology

異種材料の線膨張係数差によって発生する半田クラックを材料技術で抑制します。
Material technology to refrain a solder crack caused by mixed materials with different CTE.



No	項目	単位	L3TF	L3TV
1	熱伝導率(レーザーフラッシュ法) Thermal conductivity	W/m・K	3.2	3
2	厚み Thickness	um	110	100
3	貯蔵弾性率(25°C) Storage modulus	GPa	0.6以下	0.2以下
4	ピール強度(70um銅箔) Peel strength	N/cm	20	20
5	半田耐熱性(260°C) Solder heat resistance	min	5≦	5≦
6	絶縁破壊電圧(AC) Breakdown voltage(AC)	kV	3≦	3≦

放熱基板技術 Heat dissipation PWB technology lineup

構造例 Example	高放熱構造 High thermal dissipation	キャビティ構造 Cu cavity structure	高密度複層化 High density Multi layer
構造 Construction			
特長 Feature	高放熱高耐熱樹脂によりパワーモジュールの熱をベースメタルへ伝達。	キャビティ構造により、銅またはアルミへの直接熱伝導での放熱。	複層化することで放熱基板の高密度化を実現。キャビティ構造も対応。